PowerEdge R750xs – Informationsaktualisierung – Technisches Datenblatt



Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

(i) ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

© 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Übersicht	4
Revisionsverlauf	4
Kapitel 2: Informationsaktualisierung	5
Stromzwischenplatine entfernen	
Systemsicherheit	6
Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten	
Mindestkonfiguration für POST	
PSU – Technische Daten	

Übersicht

1

Die Informationen in diesem Dokument ersetzen die Informationen in den entsprechenden Abschnitten des Installations- und Service-Handbuchs Referenzhandbuchs für BIOS und UEFI und der Technischen Daten.

Eine vollständige Liste der Informationen finden Sie in den Dokumenten unter https://www.dell.com/poweredgemanuals.

Themen:

Revisionsverlauf

Revisionsverlauf

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Dokumentänderungen.

Tabelle 1. Revisionsverlauf des Dokuments

Dokumentversionen	Datum	Beschreibung der Änderungen			
1	November 2022	 Stromzwischenplatine entfernen BIOS, Systemsicherheit, Intel(R) SGX aktualisiert Erweiterungskarten aktualisiert Mindestkonfiguration f ür POST aktualisiert Netzteile aktualisiert 			

Informationsaktualisierung

Themen:

- Stromzwischenplatine entfernen
- Systemsicherheit
- Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten
- Mindestkonfiguration für POST
- PSU Technische Daten

Stromzwischenplatine entfernen

Voraussetzungen

- 1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
- 2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
- 3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.
- 4. Entfernen Sie das Netzteil.
- 5. Trennen Sie alle Kabel, die mit der Stromzwischenplatine verbunden sind.
- (i) ANMERKUNG: Systeme, die seit November 2022 ausgeliefert wurden, verfügen möglicherweise über eine andere Stromverteilungsplatine und Anschlüsse.

Schritte

1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (Nr. 2) die Schrauben, mit denen die Stromzwischenplatine am System befestigt ist.

(i) ANMERKUNG: Merken Sie sich, wie das Kabel verlegt ist, wenn Sie es aus dem System entfernen.

2. Heben Sie die Stromzwischenplatine aus dem System heraus.



Abbildung 1. Stromzwischenplatine entfernen

Nächste Schritte

Setzen Sie die Stromzwischenplatine wieder ein.

Systemsicherheit

Wenn Sie den Bildschirm **Systemsicherheit** anzeigen möchten, schalten Sie das System ein, drücken Sie F2 und klicken Sie auf **Hauptmenü des System-Setups** > **System-BIOS** > **Systemsicherheit**.

Option	Beschreibung
CPU AES-NI	Verbessert die Geschwindigkeit von Anwendungen durch Verschlüsselung und Entschlüsselung unter Einsatz der AES-NI-Standardanweisungen und ist per Standardeinstellung auf Enabled (Aktiviert) gesetzt. Diese Option ist standardmäßig auf Enabled festgelegt.
System Password	Richtet das Systemkennwort ein. Diese Option ist standardmäßig auf Enabled (Aktiviert) gesetzt und ist schreibgeschützt, wenn der Jumper im System nicht installiert ist.
Setup-Kennwort	Richtet das Setupkennwort ein. Wenn der Kennwort-Jumper nicht im System installiert ist, ist diese Option schreibgeschützt.
Kennwortstatus	Sperrt das Systemkennwort. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Unlocked (Entriegelt).
TPM-Informationen	Zeigt den Typ des Trusted Platform Module an, falls vorhanden.

Tabelle 2. Details zu Systemsicherheit

Tabelle 3. TPM 1.2-Sicherheitsinformationen

Option	Beschreibung			
TPM-Informationen				
TPM Security	(i) ANMERKUNG: Das TPM-Menü ist nur verfügbar, wenn das TPM-Modul installiert ist.			
	Ermöglicht es Ihnen, den Berichtsmodus des TPMs zu steuern. Standardmäßig ist die Option TPM Security (TPM-Sicherheit) auf Off (Deaktiviert) eingestellt. Die Felder "TPM Status" (TPM-Status) und "TPM			

Tabelle 3. TPM 1.2-Sicherheitsinformationen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung				
	Activation" (TPM-Aktivierung) können nur geändert werden, falls das Feld TPM Status (TPM-Status) auf On with Pre-boot Measurements (Aktiviert mit Maßnahmen vor dem Start) oder On without Pre-boot Measurements (Aktiviert ohne Maßnahmen vor dem Start) gesetzt ist.				
	Wenn TPM 1.2 ir Start , oder Akt	nstalliert wird, wird die Option TPM-Sicherheit auf Aus , Aktiviert mit Maßnahmen vor dem iviert ohne Maßnahmen vor dem Start festgelegt.			
TPM- Informationen	Zeigt den Betrie	bszustand des TPM an.			
TPM Firmware	Zeigt die TPM-F	irmware-Version an.			
TPM Status	Gibt den TPM-Status an.				
TPM-Befehl	Setzen Sie das TPM (Trusted Platform Module) ein. Bei der Einstellung Keine wird kein Befehl an das TPM gesendet. Bei der Einstellung Aktivieren ist das TPM aktiviert. Bei der Einstellung Deactivate (Deaktivieren), ist das TPM deaktiviert. Bei der Einstellung Iöschen , werden alle Inhalte des TPM gelöscht. In der Standardeinstellung ist diese Option auf None (Keine).				
Erweiterte TPM- Einstellungen	TPM PPI Bypass Provision (Bereitstellun g der TPM- PPI- Kennwortum gehung)	Wenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn Bereitstellungsvorgänge für die PPI-Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ausgegeben werden.			
	TPM PPI Bypass Clear (Löschen der TPM-PPI- Kennwortum gehung)	Wenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn Bereitstellungsvorgänge für die PPI-Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gelöscht werden.			

Tabelle 4. TPM 2.0-Sicherheitsinformationen

Option	Beschreibung				
TPM-Informationen	n				
TPM Security		RKUNG: Das TPM-Menü ist nur verfügbar, wenn das TPM-Modul installiert ist.			
	Ermöglicht e (TPM-Siche	es Ihnen, den Berichtsmodus des TPMs zu steuern. Standardmäßig ist die Option TPM Security rheit) auf Off (Deaktiviert) eingestellt.			
	Wenn TPM Standardein	2.0 installiert wird, wird die Option TPM-Sicherheit auf Ein oder auf Aus festgelegt. In der stellung ist diese Option auf Off (Deaktiviert).			
TPM- Informationen	Zeigt den Betriebszustand des TPM an.				
TPM Firmware	Zeigt die TPM-Firmware-Version an.				
TPM Hierarchy	Dient zum Aktivieren, Deaktivieren oder Löschen von Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien. Wenn diese Einstellung auf Enabled (Aktiviert) festgelegt ist, können die Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien verwendet werden.				
	Wenn diese Einstellung auf Disabled (Deaktiviert) festgelegt ist, können die Speicher- und Endorsement Key- Hierarchien nicht verwendet werden.				
	Wenn diese Einstellung auf Clear (Löschen) festgelegt ist, werden alle Werte aus den Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien gelöscht. Anschließend wird die Einstellung auf Enabled (Aktiviert) festgelegt.				
Erweiterte TPM- Einstellungen	TPM PPI Bypass Provision	PM PPI lypassWenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn Bereitstellungsvorgänge für die PPI-Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ausgegeben werden.			

Tabelle 4. TPM 2.0-Sicherheitsinformationen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung					
	(Bereitste Ilung der TPM-PPI- Kennwort umgehun g)					
	TPM PPI Bypass Clear (Löschen der TPM- PPI- Kennwort umgehun g)	Wenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn Bereitstellungsvorgänge für die PPI-Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gelöscht werden.				
	Auswahl des	Ermöglicht es dem Benutzer, die kryptografischen Algorithmen des Trusted Platform Module (TPM) zu ändern. Die verfügbaren Optionen sind von der TPM-Firmware abhängig.				
Algorithm us		Um die Auswahl des TPM2-Algorithmuszu ermöglichen, muss die Intel(R) TXT-Technologie deaktiviert sein.				
		Die Option "Auswahl des TPM2-Algorithmus" unterstützt SHA1, SHA128, SHA256, SHA512 und SM3 durch Erkennen des TPM-Moduls. Diese Option ist standardmäßig auf SHA1 festgelegt.				

Tabelle 5. Details zu Systemsicherheit

Option	Beschreibung
Intel(R) TXT	Ermöglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Option "Intel Trusted Execution Technology (TXT)". Zur Aktivierung der Option Intel TXT müssen die Virtualisierungstechnologie und die TPM-Sicherheit für TPM 1.2 mit Maßnahmen vor dem Start aktiviert oder für TPM 2.0 mit dem SHA256-Algorithmus auf On (aktiviert) festgelegt werden. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Off (Deaktiviert). Zur Unterstützung von Secure Launch (Firmware-Schutz) unter Windows 2022 wird sie auf On (aktiviert) gesetzt.
Speicherverschlüsselung	Aktiviert oder deaktiviert Intel Total Memory Encryption (TME) und Multi-Tenant (Intel [®] TME-MT). Wenn die Option auf Deaktiviert gesetzt ist, deaktiviert das BIOS die TME- und die MK-TME-Technologie. Wenn die Option auf Single Key gesetzt ist, aktiviert das BIOS die TME-Technologie. Wenn die Option auf Multiple Keys (Mehrere Tasten) gesetzt ist, aktiviert das BIOS die TME-MT-Technologie. Die Option CPU Physical Address Limit (CPU- Begrenzung physischer Adressen) muss für die Auswahl der Option Multiple Keys (Mehrere Schlüssel) deaktiviert sein. Diese Option ist standardmäßig auf Disabled festgelegt.
Intel(R) SGX	Ermöglicht das Festlegen der Option Intel Software Guard Extension (SGX). Um die Option Intel SGX zu aktivieren, muss der Prozessor SGX-fähig sein, die Speicherbelegung muss kompatibel sein (mindestens x8 identische DIMM1 bis DIMM8 pro CPU-Sockel, nicht unterstützt auf Konfiguration mit persistentem Speicher), der Speicher-Betriebsmodus muss im Optimizer-Modus eingestellt sein, die Speicherverschlüsselung muss aktiviert sein und Node Interleaving muss deaktiviert sein. Diese Option ist standardmäßig auf Aus eingestellt. Wenn diese Option auf Aus festgelegt ist, deaktiviert das BIOS die SGX-Technologie. Wenn diese Option auf Ein eingestellt ist, aktiviert das BIOS die SGX-Technologie.
In-Band-Zugriff auf SGX- Paketinformationen	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die In-Band-Option der Intel Software Guard Extension (SGX)-Paketinformationen. Diese Option ist standardmäßig auf Aus eingestellt.
PPMRR-Größe	Legt die PPMRR-Größe fest.
SGX-QoS	Aktiviert oder deaktiviert die SGX-Quality of Service.
Eingabetyp für Eigentümer- EPOCH auswählen	Ermöglicht die Auswahl von In neue zufällige Eigentümer-EPOCHs ändern oder Manuelle benutzerdefinierte Eigentümer-EPOCHs. Jedes EPOCH hat 64 Bit. Nach dem Generieren einer neuen EPOCH durch Auswählen von In neue zufällige Eigentümer-EPOCHs ändern wird die Auswahl auf Manuelle benutzerdefinierte Eigentümer-EPOCHs zurückgesetzt.

Tabelle 5. Details zu Systemsicherheit (fortgesetzt)

Option	Beschreibung		
	Software Guard Extensions Epoch n : Legt die Werte der Software Guard Extensions EPOCHs fest.		
Aktivieren von Schreibvorgängen auf SGXLEPUBKEYHASH[3:0] von	Aktiviert oder deaktiviert die Option "Aktivieren von Schreibvorgängen auf SGXLEPUBKEYHASH[3:0] von BS/SW".		
BS/SW	SGX LE Public Key Hash0 : Legt die Bytes von 0–7 für den SGX Launch Enclave Public Key Hash fest.		
	SGX LE Public Key Hash1 : Legt die Bytes von 8–15 für den SGX Launch Enclave Public Key Hash fest.		
	SGX LE Public Key Hash2 : Legt die Bytes von 16–23 für den SGX Launch Enclave Public Key Hash fest.		
	SGX LE Public Key Hash3 : Legt die Bytes von 24–31 für den SGX Launch Enclave Public Key Hash fest.		
Aktivieren/Deaktivieren des SGX Auto MP Registration Agent	Aktiviert oder deaktiviert die SGX Auto MP-Registrierung. Der MP-Registrierungs-Agent ist für die Registrierung der Plattform verantwortlich.		
SGX-Werkseinstellungen	Ermöglicht das Zurücksetzen der SGX-Option auf die Werkseinstellungen. Diese Option ist standardmäßig auf Aus eingestellt.		
Netzschalter	Aktiviert oder deaktiviert den Netzschalter auf der Vorderseite des System. Diese Option ist standardmäßig auf Enabled (Aktiviert) gesetzt.		
Netzstromwiederherstellung	Ermöglicht das Festlegen der Reaktion des Systems, nachdem die Netzstromversorgung des System wiederhergestellt wurde. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Enabled (Aktiviert). (i) ANMERKUNG: Das Hostsystem wird erst eingeschaltet, wenn iDRAC Root of Trust (RoT) abgeschlossen ist. Das Einschalten des Hosts wird nach dem Anlegen der Wechselspannung um mindestens 90 Sekunden verzögert.		
Verzögerung bei Netzstromwiederherstellung	Legt die Zeitverzögerung für die Systemeinschaltung fest, nachdem die Netzstromversorgung des Systems wiederhergestellt wurde. In der Standardeinstellung ist diese Option auf System (Sofort) gesetzt. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Immediate (Sofort). Wenn diese Option auf Sofort festgelegt ist, gibt es keine Verzögerung für das Hochfahren. Wenn diese Option auf Zufällig eingestellt ist, erzeugt das System eine zufällige Verzögerung für das Hochfahren. Wenn diese Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, wird die Verzögerungszeit bis zum Hochfahren des Systems manuell festgelegt.		
User Defined Delay (Benutzerdefinierte Verzögerung) (60 bis 600 s)	Legt die Option User Defined Delay (Benutzerdefinierte Verzögerung) fest, wenn die Option User Defined (Benutzerdefiniert) für AC Power Recovery Delay (Verzögerung bei Netzstromwiederherstellung) gewählt ist. Für die tatsächliche AC-Recovery-Zeit muss die Root-of-Trust-Zeit von iDRAC (ca. 50 Sekunden) hinzugefügt werden.		
Variabler UEFI-Zugriff	Bietet unterschiedliche Grade von UEFI-Sicherungsvariablen. Wenn die Option auf Standard (Standardeinstellung) gesetzt ist, sind die UEFI-Variablen gemäß der UEFI-Spezifikation im Betriebssystem aufrufbar. Wenn die Option auf Controlled (Kontrolliert) gesetzt ist, werden die ausgewählten UEFI-Variablen in der Umgebung geschützt und neue UEFI-Starteinträge werden an das Ende der aktuellen Startreihenfolge gezwungen.		
In-Band Benutzeroberfläche	Bei der Einstellung Deaktiviert blendet diese Einstellung Geräte der Management Engine (ME) HECI-Geräte und IPMI-Geräte des Systems gegenüber dem Betriebssystem aus. Dadurch wird verhindert, dass der Betriebssystem vom Ändern des ME Power Capping Einstellungen und blockiert den Zugriff auf alle In-Band -Management Tools. Alle Management verwaltet werden sollte über Out-of-Band Diese Option ist standardmäßig auf Aktiviert eingestellt. (i) ANMERKUNG: BIOS-Aktualisierung erfordert HECI Geräte in Betrieb sein und DUP Aktualisierungen erfordern IPMI-Schnittstelle in Betrieb sein. Diese Einstellung muss so eingestellt werden Aktiviert zu vermeiden Aktualisierungsfehler.		
SMM-Sicherheitsmigration	Aktiviert oder deaktiviert die UEFI SMM Security Migration-Schutzmaßnahmen. Es ist für die Unterstützung von Windows 2022 aktiviert.		

Tabelle 5. Details zu Systemsicherheit (fortgesetzt)

Option	Beschreibung					
Sicherer Start	Ermöglicht den Sicherungsstar Start) ist in der festgelegt.	sicheren Start, indem das BIOS jedes Vorstart-Image mit den Zertifikaten in der trichtlinie bzw. Regel für sicheren Start authentifiziert. "Secure Start" (Sicherer Standardeinstellung deaktiviert. Sicherer Start ist standardmäßig auf Standard				
Regel für sicheren Start	Wenn die Richtlinie für den sicheren Start auf Standard eingestellt ist, authentifiziert das BIOS die Vorstart-Images mithilfe des Schlüssels und der Zertifikate des Systemherstellers. Wenn die Richtlinie für den sicheren Start auf Custom (Benutzerdefiniert) eingestellt ist, verwendet das BIOS benutzerdefinierte Schlüssel und Zertifikate. Die Richtlinie für den sicheren Start ist standardmäßig auf Standard festgelegt.					
Secure Boot Mode	Legt fest, wie c	las BIOS die Regel für sicheren Start Objekte (PK, KEK, db, dbx).				
	Wenn der aktuelle Modus eingestellt ist zum Modus "Bereitgestellt" , die verfügbaren Optionen sind Benutzermodus und Modus "Bereitgestellt" . Wenn die aktuelle Modus ist Benutzermodus , die verfügbaren Optionen sind Benutzermodus , Prüfmodus , und Modus "Bereitgestellt" .					
	Tabelle 6. Se	ecure Boot Mode				
	Optionen	Beschreibungen				
	Benutzerm Im Benutzermodus, PK muss installiert sein, und das BIOS führt die Signaturüberprüfung auf programmatischer versucht, Regel zum Aktualisieren Objekte. Aktualisieren Objekte. die Signaturüberprüfung auf programmatischer versucht, Regel zum					
	Das BIOS nicht zugelassener programmatischer Übergänge zwischen Modi.					
	Audit- ModusIm Audit-Modus ist PK nicht vorhanden. Das BIOS bestätigt programmgesteuerte Aktualisierungen der Richtlinienobjekte und Übergänge zwischen den Modi nicht. Das BIOS führt eine Signaturüberprüfung der Vorstart-Images durch und protokolliert die Ergebnisse in der Ausführungsinformationen-Tabelle der Images, wobei die Images ausgeführt werden, unabhängig davon, ob sie die Prüfung bestanden haben oder nicht. Der Audit Mode (Audit-Modus) eignet sich für die programmgesteuerte					
	Modus Modus Bereitgestellt ist die sicherste Modus. Im Modus Bereitgestellt, It PK muss installiert sein und der BIOS führt die Signaturüberprüfung auf programmatischer versucht, Regel zum Aktualisieren Objekte.					
	Modus Bereitgestellt schränkt die programmatischer Mode-Übergänge.					
Richtlinie zum sicheren Start – Übersicht	Gibt die Liste der Zertifikate und Hashes für den sicheren Start an, die beim sicheren Start für authentifizierte Images verwendet werden.					
Benutzerdefinierte Einstellungen für die Richtlinie zum sicheren Start	 Konfiguriert die Secure Boot Custom Policy. Um diese Option zu aktivieren, stellen Sie die sichere Startrichtlinie auf Custom (Benutzerdefinierte) Option. Die folgende Liste enthält Beschreibungen der verfügbaren benutzerdefinierten Einstellungen für die Secure Boot-Richtlinie: Platform Key (PK): Importieren, Exportieren, Löschen oder Wiederherstellen des Plattformschlüssels (Platform Key, PK) Key Exchange Key Database (KEK): Importieren, Exportieren, Löschen oder Wiederherstellen von Einträgen in der KEK-Datenbank (Key Exchange Key) Authorized Signature Database (db): Importieren, Exportieren, Löschen oder Wiederherstellen von Einträgen in der Authorized Signature-Datenbank (db) Forbidden Signature Database (dbx): Importieren, Exportieren, Löschen oder Wiederherstellen von Einträgen in der Forbidden Signature-Datenbank (dbx) Delete All Policy Entries (PK, KEK, db, and dbx): Wiederherstellen der Standardeinträge des Systemherstellers für die PK-, KEK-, db- und dbx-Datenbank. Alle importieren Einträge werden entfernt. 					

Tabelle 5. Details zu Systemsicherheit (fortgesetzt)

Option	Beschreibung				
	•	Export Firmware Hash Values : Exportieren von Werten für Firmware-Images von Drittanbietern, wie z. B. Netzwerk-Controller-Firmware und Speicher-Controller-Firmware			
		 Select Firmware Image: Dies ist eine Liste der Firmware-Images von Drittanbietern, die das System bei diesem Startvorgang zu laden versucht hat. Wählen Sie ein Image und anschließend "Export" aus, um den SHA-256-Hash-Wert des Image in eine Datei zu schreiben. 			
		• Export Selected Entry: Schreiben des ausgewählten Datenbankeintrags in eine Datei			

Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten



Abbildung 2. Erweiterungskarten-Steckplätze

- 1. SIG_PWR_0 (Riser-Stromkabel für Riser 1A und Riser 1B)
- 2. SL6_CPU2_PB3 (PCIe-Kabelanschluss für Riser 1A und Riser 1B)
- 3. SL5_CP2_PA1 (PCIe-Kabelanschluss für Riser 1B)
- 4. SL7_CPU1_PA4 (PCIe-Kabelanschluss für Riser 1A und Riser 1B)
- 5. SL8_CPU1_PB4 (PCIe-Kabelanschluss für Riser 1A und Riser 1B)

Die folgende Tabelle die Konfigurationen zu den Erweiterungskarten-Risern:

Tabelle 7. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen

Konfiguratio nen	Erweiterungs karten-Riser	PCIe- Steckplätze	Steuern des Prozessors	Höhe	Baulänge	Steckplatzbr eite	Stromversorgu ng
Config0.	R1A	3	Prozessor 1	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W

Konfiguratio nen	Erweiterungs karten-Riser	PCle- Steckplätze	Steuern des Prozessors	Höhe	Baulänge	Steckplatzbr eite	Stromversorgu ng
		4	Prozessor 2	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W
Konfig1.	R1B	3	Prozessor 1 und 2	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W
		4	Prozessor 1	Low-Profile	Halbe Baulänge	×8	75 W
Config2.	R1B	3	Prozessor 1 und 2	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W
		4	Prozessor 1	Low-Profile	Halbe Baulänge	×8	75 W
Config3.	R1A	3	Prozessor 1	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W
		4	Prozessor 2	Low-Profile	Halbe Baulänge	x16	75 W
Config4.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Config5.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Tabelle 7. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

(i) ANMERKUNG: Es kann jeweils nur ein Kabel-Riser in einer bestimmten Konfiguration installiert werden.

(i) **ANMERKUNG:** R1B ist ein SNAPI-Riser.

(i) **ANMERKUNG:** Die Konfigurationen 4 und 5 sind Konfigurationen ohne Riser.



Abbildung 3. Riser 1A

- 1. Steckplatz 3
- 2. Steckplatz 4



Abbildung 4. Riser 1B (SNAPI)

- 1. Steckplatz 3
- 2. Steckplatz 4

(i) ANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplätze sind nicht hot-swap-fähig.

Die folgende Tabelle enthält Vorschläge für die Installation von Erweiterungskarten hinsichtlich bestmöglicher Kühlung und mechanischer Unterbringung. Die Erweiterungskarten mit der höchsten Priorität müssen zuerst installiert werden und dabei die angegebene Steckplatzpriorität erhalten. Alle anderen Erweiterungskarten müssen nach Kartenpriorität und in der Reihenfolge der Steckplatzpriorität installiert werden.

Tabelle 8. Konfiguration 0: R1A

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Serielles Portmodul von Dell (LP)	2	1
fPERC	Integrierter Steckplatz	1
Interner PERC-Adapter	1	1
Externer Dell Adapter	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1, 6, 3	3
Mellanox (NIC: 100Gb)	4, 3, 5, 6, 1	5
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (NIC: 25GbE)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (NIC: 25 Gb)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (NIC: 10 Gb)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (HBA: FC32)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Marvell (HBA: FC32)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Emulex (HBA: FC32)	1, 6, 5, 3, 4	5
Avago (HBA: FC16)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (HBA: FC16)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (NIC: 10GbE)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6

Tabelle 8. Konfiguration 0: R1A (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzpriorität		Maximale Anzahl an Karten
Intel (NIC: 10 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (NIC: 10 Gb)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (NIC: 1 GB)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (NIC: 1 GB)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (OCP: 100Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Dell BOSS S2-Modul	Integrierter Steckplatz	1
Samsung (PCle-SSD-AIC)	4, 3, 5, 6, 1, 2	1

Tabelle 9. Konfiguration 1: R1B

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Serielles Portmodul von Dell (LP)	2	1
fPERC	Integrierter Steckplatz	1
Interner PERC-Adapter	1	1
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1, 6	2
Mellanox (NIC: 100Gb)	5, 6, 1	3
Intel (NIC: 25GbE)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Mellanox (NIC: 25Gb)	3	1
QLogic (NIC: 25 Gb)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (HBA: FC32)	5, 6, 1, 4, 3, 2	3
Marvell (HBA: FC32)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Emulex (HBA: FC32)	1, 6, 5, 4	4
Avago (HBA: FC16)	5, 6, 1, 4, 3, 2	3
QLogic (HBA: FC16)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (NIC: 10GbE)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Intel (NIC: 10 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
QLogic (NIC: 10 Gb)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6

Tabelle 9. Konfiguration 1: R1B (fortgesetzt)

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Broadcom (NIC: 1 GB)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Intel (NIC: 1 GB)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Mellanox (NIC: HDR100 VPI)	3	1
Intel (OCP: 100Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Externer Dell PERC-Adapter	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Dell BOSS S2-Modul	Integrierter Steckplatz 1	
Samsung (PCle-SSD-AIC)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6

Tabelle 10. Konfiguration 2: R1B

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Serielles Portmodul von Dell (LP)	2	1
Interner PERC-Adapter	1	1
12-Gbps-SAS-HBA	1	1
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb)	4, 3, 5, 6, 1	5
Mellanox (NIC: 100Gb)	5, 6, 1	3
Intel (NIC: 25GbE)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Mellanox (NIC: 25Gb)	3	1
QLogic (NIC: 25 Gb)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (NIC: 10GbE)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Broadcom (HBA: FC32)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Marvell (HBA: FC32)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Emulex (HBA: FC32)	1, 6, 5, 4	4
Avago (HBA: FC16)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
QLogic (HBA: FC16)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Intel (NIC: 10 Gbit)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6

Tabelle 10. Konfiguration 2: R1B (fortgesetzt)

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
QLogic (NIC: 10 Gb)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Intel (NIC: 1 GB)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6
Mellanox (NIC: HDR100 VPI)	3	1
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz 1	
Externer Dell PERC-Adapter	1	1
Dell BOSS S2-Modul	Integrierter Steckplatz	1
Samsung (PCIe-SSD-AIC)	5, 6, 1, 4, 3, 2	6

Tabelle 11. Konfiguration 3: R1A

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Serielles Portmodul von Dell (LP)	2	1
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1, 6, 3	3
Intel (NIC: 100 Gb)	4, 3, 5, 6, 1	5
Mellanox (NIC: 100Gb)	4, 3, 5, 6, 1	5
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (NIC: 25GbE)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Mellanox (NIC: 25Gb)	3	1
QLogic (NIC: 25 Gb)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (HBA: FC32)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Marvell (HBA: FC32)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Emulex (HBA: FC32)	1, 6, 5, 3, 4	5
Avago (HBA: FC16)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (HBA: FC16)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (NIC: 10GbE)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (NIC: 10 Gbit)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
QLogic (NIC: 10 Gb)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Broadcom (NIC: 1 GB)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Intel (NIC: 1 GB)	4, 3, 5, 6, 1, 2	6

Tabelle 11. Konfiguration 3: R1A (fortgesetzt)

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Mellanox (NIC: HDR100 VPI)	3	1
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Externer Dell PERC-Adapter	4, 3, 5, 6, 1, 2	6
Dell BOSS S2-Modul	Integrierter Steckplatz	1
Samsung (PCle-SSD-AIC)	4, 3, 5, 6, 1, 2	2

Tabelle 12. Konfiguration 4: ohne Riser

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Serielles Portmodul von Dell (LP)	1	1
fPERC	Integrierter Steckplatz	1
Interner PERC-Adapter	1	1
12-Gbps-SAS-HBA	1	1
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1, 6	2
Intel (NIC: 100 Gb)	5, 6, 1	3
Mellanox (NIC: 100Gb)	5, 6, 1	3
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 2	1
Intel (NIC: 25GbE)	5, 6, 1, 2	1
Mellanox (NIC: 25Gb)	Nicht unterstützt	-
QLogic (NIC: 25 Gb)	5, 6, 1, 2	1
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	5, 6, 1, 2	4
Broadcom (HBA: FC32)	5, 6, 1, 2	4
Marvell (HBA: FC32)	5, 6, 1, 2	4
Emulex (HBA: FC32)	1, 6, 5	3
Avago (HBA: FC16)	5, 6, 1, 2	4
QLogic (HBA: FC16)	5, 6, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 10GbE)	5, 6, 1, 2	4
Intel (NIC: 10 Gbit)	5, 6, 1, 2	4
QLogic (NIC: 10 Gb)	5, 6, 1, 2	4
Broadcom (NIC: 1 GB)	5, 6, 1, 2	4

Tabelle 12.	Konfiguration	4: ohne	Riser	(fortgesetzt)
-------------	---------------	---------	-------	---------------

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten
Intel (NIC: 1 GB)	5, 6, 1, 2	4
Mellanox (NIC: HDR100 VPI)	Nicht unterstützt	-
Mellanox (NIC: HDR VPI)	Nicht unterstützt	-
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1
Externer Dell PERC-Adapter	5, 6, 1, 2	4
Dell BOSS-S1-Modul	Integrierter Steckplatz	1
Samsung (PCle-SSD-AIC)	5, 6, 1, 2	4
Intel (PCIe-SSD)	Nicht unterstützt	-

Tabelle 13. Konfiguration 5: ohne Riser

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten		
Serielles Portmodul von Dell (LP)	1	1		
fPERC	Integrierter Steckplatz	1		
Interner PERC-Adapter	1	1		
12-Gbps-SAS-HBA	1	1		
Mellanox (NIC: 200 Gbit)	1	1		
Intel (NIC: 100 Gb)	1	1		
Mellanox (NIC: 100Gb)	1	1		
Broadcom (NIC: 25 Gbit)	1, 2	1		
Intel (NIC: 25GbE)	1, 2	1		
Mellanox (NIC: 25Gb)	Nicht unterstützt	-		
QLogic (NIC: 25 Gb)	1, 2	1		
SolarFlare (NIC: 25 Gbit)	1, 2	4		
Broadcom (HBA: FC32)	1, 2	4		
Marvell (HBA: FC32)	1, 2	4		
Emulex (HBA: FC32)	1	1		
Avago (HBA: FC16)	1, 2	4		
QLogic (HBA: FC16)	1, 2	4		
Broadcom (NIC: 10GbE)	1, 2	4		

Tabelle 13. Konfiguratior	5: ohne	Riser	(fortgesetzt)
---------------------------	---------	-------	---------------

Kartentyp	Steckplatzpriorität	Maximale Anzahl an Karten		
Intel (NIC: 10 Gbit)	1, 2	4		
QLogic (NIC: 10 Gb)	1, 2	4		
Broadcom (NIC: 1 GB)	1, 2	4		
Intel (NIC: 1 GB)	1, 2	4		
Mellanox (NIC: HDR100 VPI)	Nicht unterstützt	-		
Mellanox (NIC: HDR VPI)	Nicht unterstützt	-		
Broadcom (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Intel (OCP: 25GbE)	Integrierter Steckplatz	1		
Marvell (OCP: 25Gb)	Integrierter Steckplatz	1		
Mellanox (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
SolarFlare (OCP: 25 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Broadcom (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Marvell (OCP: 10Gb)	Integrierter Steckplatz	1		
Intel (OCP: 10 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Broadcom (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Intel (OCP: 1 GB)	Integrierter Steckplatz	1		
Externer Dell PERC-Adapter	1, 2	4		
Dell BOSS-S1-Modul	Integrierter Steckplatz	1		
Samsung (PCIe-SSD-AIC)	1, 2	4		
Intel (PCIe-SSD)	Nicht unterstützt	-		

Mindestkonfiguration für POST

Die im Folgenden aufgeführten Komponenten sind die Mindestkonfiguration für POST:

- Ein Netzteil
- Systemplatine
- Stromzwischenplatine (PIB) und Kabel
- Ein Prozessor in Sockel Prozessor 1
- Ein Speichermodul (DIMM) in Sockel A1 installiert

PSU – Technische Daten

Das PowerEdge R750xs-System unterstützt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstrom-Netzteile (PSUs).

Tabelle 14. PSU – Technische Dat

Stromverso rgungseinh eit	Klasse Wärmeabg be (maximal)	Wärmeabga	Frequency (Speicherta ktrate)	Spannung	Wechselstrom (AC)		Gleichstro	Strom
		be (maximal)			Hohe Netzspann ung 200– 240 V	Niedrige Netzspannu ng 100–120 V	m (DC)	
1400 W im gemischten Modus	Platin	5.250 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V Wechselspann ung	1400 W	1050 W	-	12 A-8 A
	-	5.250 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	1400 W	6,6 A
1.100 W im gemischten Modus	Titan	4.125 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V Wechselspann ung	1100 W	1050 W	-	12 A / 6,3 A
	-	4.125 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	1100 W	5,2 A
1100 W Gleichstrom	-	4.265 BTU/h	-	-48–(-60) V	-	-	1100 W	27 A
800 Wim gemischten Modus	Platin	3.000 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V Wechselstrom, autom. Bereichseinstel lung	800 W	800 W	-	9,2–4,7 A
	-	3.000 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	800 W	3,8 A
600 W im gemischten Modus	Platin	2.250 BTU/h	50/60 Hz	100-240 V Wechselstrom, autom. Bereichseinstel lung	600 W	600 W	-	7,1–3,6 A
	-	2.250 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	600 W	2,9 A
700 W im gemischten Modus	Titan	2.625 BTU/h	50/60 Hz	200–240 V Wechselstrom	700 W	-	-	4,1 A
	-	2.625 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	700 W	3,4 A
1.800 W im gemischten Modus	Titan	6.000 BTU/h	50/60 Hz	200–240 V Wechselstrom	1.800 W	-	-	10 A
	-	6000 BTU/h	-	240 V Gleichstrom	-	-	1.800 W	8,2 A

(i) ANMERKUNG: Dieses System ist außerdem für den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Außenleiterspannung von höchstens 240 V konzipiert.

(i) ANMERKUNG: Die Wärmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

() ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswählen und Aufrüsten der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu prüfen und eine optimale Energienutzung zu gewährleisten.